

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_电话会议_
参与单位名称及人员姓名	华夏基金、中信证券、中邮证券、野村东方国际证券、第一创业证券、华福证券、宁泉资产、信达证券共 8 人
时间	2026 年 4 月 24 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：胡金先生 董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况</p> <p>简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。</p> <p>二、投资者会议问答交流</p> <p><b>Q1：公司主要竞争优势是什么？</b></p> <p><b>A1：</b>公司深耕半导体显示设备行业二十余年，经历了显示产业的多种技术变革，通过多年的技术沉淀和积累实现了半导体显示产业各种技术之间的掌握和融合，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。公司凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势，以及全方位的、高质量的售前、售中、售后个性化、定制化服务，公司在业内树立了良好的口碑，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，与包括大陆汽车电子、博世、伟世通、哈曼、京东方、维信诺、深天马、德赛西威、华星光电、苹果、富士康、业成、蓝思科技、惠科等知名企业建立了良好的紧密的合作关系。</p>

**Q2：公司在半导体先进封装领域有哪些布局？**

**A2：**公司一直积极布局半导体领域，已经凭借研发成功的半导体 IC 封装设备顺利切入半导体封测行业。在先进封装领域，公司有针对显示驱动芯片键合设备（ILB 设备），该倒装设备是一种采用共晶+倒装的芯片键合工艺的高精度高速度先进封装设备。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势，积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。

**Q3：公司设备在手机折叠屏领域的业务布局和应用发展情况如何？**

**A3：**公司柔性 AMOLED 贴合类设备已经广泛运用国内外知名终端客户手机折叠屏的量产。公司与国内外多家智能手机知名品牌制造商保持良好的合作关系，并持续就柔性屏创新性作用开展深入合作。面向折叠屏市场，公司适用于 UTG 超薄柔性玻璃的贴附类设备已实现向行业头部客户批量出货，为公司开拓新市场、构建竞争优势、培育新利润增长点打下了坚实基础。

**Q4：公司在固态电池及新能源其他业务方面有哪些产品？**

**A4：**在新能源设备领域，公司已形成覆盖锂电池包蓝膜、固态/半固态电池超声焊接、切叠一体机、电芯装配及 Pack 段整线自动化设备产品矩阵。同时，公司积极布局钙钛矿相关工艺设备的研发，在 GW 级涂布设备、VCD 设备和 HP 设备领域取得关键突破，相关设备已在客户端中试线实现稳定运行。后续公司将加强新能源设备自动化、一体化和智能化研发，力争实现迭代和创新，更好地满足下游客户需求，提升客户的合作粘性和深度，提高产品竞争力。

**Q5：公司主要业绩驱动因素是什么？**

**A5：**公司所处的行业为技术密集型行业，持续的技术储备与创新能力是公司发展的核心驱动力。公司始终以市场及客户需求为导向，加强前瞻性技术储备和产品研发，持续聚焦新型半导体显示设备、半导体设备及新能源设备领域的研发创新，已成功推出 AMOLED G8.6 代中前段工艺贴膜设备、UTG 贴合设备、显示驱动芯片倒装设备（ILB）、钙钛矿涂布三件套等核心产品，研发成果稳步落地。随着行业景气度逐步回升，公司将依托自身领先的技术水平、优质的产品体系、高效的服务能力、深厚的客户

	资源，叠加长期积累的人才与管理优势，为实现持续、健康、稳健的高质量发展提供坚实支撑。
附件清单（如有）	无
日期	2026-4-24